

Ni-777 光镍电镀工艺

Brighter-777 NICKEL PLATING PROCESS

(一) 特点

1. 出光速度快，非常优异的套铬性能和与其它镀层良好的结合力。
2. 镀层柔软，均镀能力强，低电位覆盖力极佳。
3. 操作稳定，分解产物少，杂质容忍亦高。
4. 适合作为青铜、金、银等金属之光亮镍底层，特别适用于形状复杂工件电镀。

(二) 镀液组成及操作条件

原料及操作条件	范围	标准
硫酸镍 (NiSO ₄ 6H ₂ O)	200-280 克/升	250 克/升
氯化镍 (NiCl ₂ 6H ₂ O)	40 - 70	50 克/升
硼酸 (H ₃ BO ₃)	40 - 55	45 克/升
主光剂 Ni-777 (Brighter Ni-777)	0.5-1.5	1 毫升/升
柔软剂 (Red Label Additive)	5-12	10 毫升/升
辅助剂 S-1 (Nickel Additive S-1)	1-4	3 毫升/升
湿润剂 Y-19 (Nickel Additive Y-19)	0.5-1.5	0.5 毫升/升
温度	50 - 60 ℃ (< 65 ℃)	55 ℃
pH	4.0 - 4.8	4.5
阴极电流密度	0.5 - 2 安培/平方分米	
电流效率	95 - 98%	
沉积速度 (55 ℃, 5ASD)	1um/分钟	

(三) 配制镀液

如需继续阅读或下载其他技术参数内容，欢迎扫码联系获取更多.....

